

# 高精準性元素控制薄膜沈積系統

## 注意事項

1. 本機台僅接受委託代工，不開放外部使用者操作，內部使用者及同仁均需通過考核方可使用。
2. 每張申請單，最多可申請 3 片晶圓進行委託。
3. 本設備提供 6 吋、8 吋或破片矽晶片進入。為避免金屬粒子汙染 ALD 反應室，影響薄膜品質，待鍍基板之表面禁止有裸露的所有種類金屬電極。如有特殊情況，請先與設備工程師討論。

## 實驗室機台設備安全宣告

1. 此系統只允許核可使用人員才能操作。
2. 設備使用前，請務必檢查機台狀況、溫度、壓力是否正常。
3. 操作期間無論發生有感地震、停電、毒氣或火災警報的狀況時，所有的人必須立即循逃生方向撤離實驗室。
4. 遇有氣體外洩、火災燃燒或人員傷害等緊急狀況時，請通知 **緊急應變指揮中心協助處理(分機 7761& 7762)**。
5. 確認使用該機台可能需要防護具的使用方法及其所在位置，例如：緊急沖淋器、空氣呼吸器、滅火器、藥膏等。
6. 使用設備需確實登入及填寫使用紀錄簿。